

Esquema para la Promoción de la Fabricación de Componentes y Semiconductores Electrónicos (SPECS)

1. Antecedente

El Gobierno da una alta prioridad a la fabricación de hardware electrónico, ya que es uno de los pilares importantes de los programas “Crea en India” e “India Digital” del Gobierno de la India. La industria de fabricación de electrónicos en la India presenta una deficiencia del 8-10% en comparación con las economías de la competencia en diferentes segmentos de la fabricación de electrónicos, así como en diferentes niveles de la cadena de valor.

1.2 La fabricación interna de electrónicos ha aumentado sustancialmente en los últimos años y está moviéndose con firmeza del nivel de fabricación semidesarmado (SKD) al completamente desarmado (CKD). Sin embargo, el valor agregado interno continúa siendo bajo y se encuentra solo en el 10-30%. Esto se debe a la falta de un ecosistema de fabricación de componentes electrónicos, a la casi ausencia de un ecosistema de fabricación de semiconductores y a la ausencia de un ecosistema de fabricación de pantallas en el país. El mayor crecimiento de la fabricación nacional de electrónicos ha ocurrido gracias al ensamblaje de productos terminados a partir de componentes/subconjuntos/partes electrónicas importadas, principalmente para atender la demanda interna.

1.3 El desarrollo de una cadena de suministro es esencial para la fabricación de productos electrónicos con un mayor valor agregado interno. La visión de la Política Nacional de Electrónica 2019 (NPE 2019) anunciada el 25.02.2019 es posicionar a la India como un centro global para la Fabricación y Diseño de Sistemas Electrónicos (ESDM) al alentar y mejorar las capacidades en el país

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

para el desarrollo de componentes clave, incluyendo los chips, y creando un entorno que permita a la industria competir a nivel global.

1.4 La fabricación de componentes y semiconductores electrónicos necesita capital y debe lidiar con los cambios constantes de la tecnología. Los componentes están en el corazón de los productos electrónicos y constituyen una parte importante del valor total de la Lista de Materiales (BOM). Un ecosistema de fabricación de componentes electrónicos exitoso es vital para el crecimiento general y sostenible a largo plazo de la fabricación de electrónicos en la India y para alcanzar una Balanza de Pagos (BoP) positiva.

1.5 Los principales impedimentos para atraer inversiones para la fabricación de componentes/semiconductores electrónicos incluyen la importación con Derechos Aduaneros Básicos (BCD) “nulos”, ya que la mayoría de los componentes/semiconductores electrónicos están cubiertos bajo el Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA-1) de la Organización Mundial de Comercio (WTO); un alto costo de capital para establecer capacidades de escala global para ser competitivos; infraestructura inadecuada; falta de disponibilidad de energía adecuada, confiable y de calidad, además de un suministro de agua a tasas competitivas; falta de cadena de suministro; altos costos logísticos; falta de tecnología, etc.

1.6 El Esquema de Paquete de Incentivo Especial Modificado (M-SIPS) fue diseñado como un plan para proporcionar incentivos financieros a fin de ayudar a compensar la deficiencia y el alto costo inicial, y de esta forma atraer inversiones en el sector de la fabricación de electrónicos. Este esquema estaba abierto a postulaciones hasta el 31.12.2018 para nuevos proyectos y proyectos de expansión. El esquema proporcionó subsidio para inversiones de gastos de capital con el objeto de establecer instalaciones de fabricación de productos electrónicos

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

(20% para unidades en Zonas Económicas Especiales (SEZ) y 25% para unidades que no están en SEZ). M-SIPS ha tenido un rol importante en la promoción de inversiones para la fabricación de productos electrónicos en la India.

2. Esquema para la Promoción de la Fabricación de Componentes y Semiconductores Electrónicos (SPECS)

2.1 Propone ofrecer un incentivo inicial del 25% del gasto de capital para la fabricación de bienes según la lista anexada que constituya la cadena de suministro de un producto electrónico bajo el Esquema para la Promoción de la fabricación de Componentes y Semiconductores Electrónicos (SPECS).

3. Objetivo

3.1 El esquema ayudará a compensar la deficiencia en la fabricación interna de componentes y semiconductores para fortalecer el ecosistema de fabricación de electrónicos en el país.

4. Elegibilidad

4.1 El SPECS será aplicable a inversiones en nuevas unidades, además de la expansión de la capacidad/modernización y diversificación de las unidades existentes.

5. Límite del Umbral

5.1 El umbral mínimo de inversión para ser elegible bajo el esquema está anexado.

5.2 Los umbrales son los mismos para las nuevas unidades o la expansión de la capacidad/modernización y diversificación de las unidades existentes.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

5.3 Se realizarán revisiones periódicas según los cambios, de haber alguno, a la lista de bienes/umbrales para los cuales son proporcionados los incentivos.

6. Vigencia del Esquema

6.1 El SPECS estará abierto para solicitudes inicialmente por 3 años desde la fecha de su notificación. Las postulaciones recibidas bajo el esquema serán evaluadas constantemente y su implementación continuará según sean aprobadas bajo el esquema.

7. Incentivos bajo el Esquema

7.1 Se proporcionará un incentivo del 25% de gastos de capital a las unidades que están realizando inversiones para los bienes según la lista anexada. El incentivo será proporcionado con un sistema de reembolso.

7.2 El gasto de capital será el total del gasto en planta, maquinaria, equipos, servicios asociados y tecnología, incluyendo la Investigación y Desarrollo (I&D). Los detalles de esos gastos de capital elegibles se incluirán en las directrices. Para el cálculo del incentivo a este respecto, deberá considerarse el valor total de la planta, la maquinaria y los equipos renovados (incluyendo los servicios asociados y la I&D), ya sean importados o adquiridos en la nación, que no exceda el 20% del total de la planta, la maquinaria y los equipos elegibles (incluyendo los servicios asociados y la I&D).

7.3 Los incentivos, en caso de que haya alguno, ofrecidos por el Gobierno del Estado, o cualquiera de sus agencias o cuerpos locales, deberá estar por encima de los incentivos elegibles bajo el esquema propuesto.

7.4 Los postulantes también serán elegibles para beneficiarse de cualquier otro esquema del Gobierno de la India. Sin embargo, las inversiones comprometidas

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

por los postulantes bajo el esquema M-SIPS cuyos incentivos hayan sido reclamados no calificarán como inversiones elegibles bajo el esquema SPECS.

8. Aprobación y Proceso de Desembolso

8.1 La postulación al Esquema puede ser realizada por cualquier empresa registrada en la India.

8.2 Cada postulación debe ser tratada como una nueva inversión y será manejada como una postulación independiente. La postulación solo deberá ser para proyectos de una sola fase y las postulaciones por fases no serán consideradas por el Esquema. No hay ninguna restricción para que un solicitante pueda realizar múltiples postulaciones y/o para múltiples ubicaciones.

8.3 Una postulación inicial completa en todos los aspectos y enviada antes de la fecha límite será evaluada de manera constante y considerada para su aprobación.

8.4 El incentivo bajo el esquema será aplicable desde la fecha de reconocimiento de la solicitud. El reconocimiento será emitido después de un escrutinio inicial de la postulación. El reconocimiento de la postulación no deberá ser considerado como la aprobación bajo el SPECS.

8.5 El incentivo estará disponible para la inversión dentro de 5 años desde la fecha de reconocimiento de la postulación.

8.6 El incentivo contra el gasto de capital elegible será liberado después de la aprobación de la postulación, la cual está sujeta al gasto de capital que exceda el valor del umbral y el comienzo de la producción comercial. Los pedidos subsiguientes del incentivo pueden ser enviados cada seis meses.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

8.7 La unidad que reciba un incentivo bajo SPECS deberá permanecer en producción comercial por un periodo de al menos 3 (tres) años desde la fecha del comienzo de la producción o 1 (un) año desde la fecha del recibo del último incentivo, lo que ocurra más tarde.

9. Mecanismo de Gobierno

9.1 El esquema será implementado a través de una Agencia Nodal. La Agencia Nodal realizará la evaluación de la postulación.

9.2 Esta Agencia Nodal actuará como una Agencia de Administración de Proyectos (PMA) y será responsable de proporcionar apoyo en materia de secretaría, gestión e implementación, además de encargarse de otras responsabilidades asignadas por MeitY de vez en cuando. Las responsabilidades, el funcionamiento y la constitución de la PMA estarán detalladas en las Guías del Esquema, las cuales serán emitidas por separado por MeitY.

9.3 Para realizar actividades relacionadas con la implementación del Esquema SPECS, la PMA será responsable de:

9.3.1 Recibir la solicitud, emitir reconocimientos, realizar la evaluación y verificar la elegibilidad de los postulantes que serán apoyados por el Esquema.

9.3.2 Examinar los pedidos de desembolso y desembolsar el incentivo a los postulantes aprobados.

9.3.3 Enviar informes periódicos al MeitY sobre el progreso y el rendimiento del Esquema.

9.4 La PMA colocará las postulaciones que han sido evaluadas y encontradas elegibles ante el Comité Ejecutivo (EC), que estará constituido por el Ministerio

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY). El EC estará liderado por un oficial de un rango no menor a secretario conjunto en MeitY. El EC estará compuesto por representantes de los ministerios, departamentos y organizaciones relevantes. Las responsabilidades, el funcionamiento y la constitución del EC estarán detallados en las Guías del Esquema.

9.5 El EC recomendará a la PMA la aprobación/rechazo/modificación de las postulaciones. Basándose en las recomendaciones del EC, la PMA emitirá una carta de aprobación al postulante con una copia al MeitY.

9.6 El MeitY realizará créditos presupuestarios para el desembolso de incentivos a los proyectos aprobados bajo el esquema. El desembolso de los incentivos será realizado por la PMA basándose en las condiciones de la aprobación y según sus reglas financieras. La PMA enviará los requerimientos presupuestarios al MeitY como un monto consolidado regularmente y no por cada proyecto.

9.7 El progreso del Esquema será revisado a través de un Consejo Gobernante (GC) que será constituido por el MeitY bajo el liderazgo de un secretario de MeitY. El GC estará compuesto por expertos del Gobierno y la Industria. El GC revisará periódicamente el progreso del Esquema y los proyectos. Asimismo, será la autoridad que podrá realizar mejoras/modificaciones en las Guías del Esquema de vez en cuando para la implementación exitosa del Esquema. Las responsabilidades, la constitución y el funcionamiento del GC estarán detallados en las Guías del Esquema.

9.8 La lista de bienes elegibles para el incentivo bajo el Esquema, junto con los umbrales aplicables, serán revisados y corregidos de vez en cuando por el Consejo Gobernante.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

9.9 Para el funcionamiento efectivo del esquema SPECS, un conjunto de guías de Evaluación y Desembolso serán creadas por el MeitY y serán emitidas de forma separada.

9.10 Se realizará una evaluación a mediano plazo del esquema para valorar los beneficios cosechados por la industria y la economía según los objetivos estipulados.

Lista de Bienes Elegibles para un Incentivo bajo SPECS

A. Lista de bienes con un Límite de Umbral de Inversión Mínima de 5 rupias crore

S.No	Descripción de los Bienes
1.	Componentes SMT incluyendo chips LED
2.	Módulos de chip para tarjetas inteligentes, antenas y etiquetas RFID, CoB/Sistema en paquete
3.	Componentes pasivos incluyendo resistores, condensadores, ferritas, etc., para aplicaciones electrónicas
4.	Componentes electromecánicos incluyendo transformadores, inductores, bobinas, relevadores, interruptores, micromotores, motores paso a paso, motores de imanes permanentes, conectores, disipadores, antenas, parlantes, micrófonos, etc., para aplicaciones electrónicas
5.	Magnetrones, guía de ondas, circuladores, acopladores, aisladores, filtros, imanes, componentes RF para aplicaciones electrónicas
6.	Circuitos impresos (PCB), PCB laminados, prepregs, cintas de fotopolímero, tintas de impresión PCB; electrónicos flexibles impresos
7.	Sensores, transductores, actuadores, cristales para aplicaciones electrónicas
8.	Módulos de cámara, motor vibrador/timbre
9.	Cables USB/DATOS, Cables HDMI
10.	Bienes capitales para todos los bienes cubiertos bajo SPECS

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

B. Lista de Bienes con un Límite de Umbral de Inversión Mínima de 15 rupias crore

S. No.	Descripción de los bienes
1.	Componentes activos: a. Dispositivos semiconductores discretos, tales como transistores, diodos, etc. b. Semiconductores de potencia, incluyendo FET, MOSFET, tiristor, etc.
2.	Preforma de fibra óptica y de sílice
3.	Montaje de pantalla y montaje de cubierta de vidrio/panel touch

C. Lista de Bienes con un Límite de Umbral de Inversión Mínima de 25 rupias crore

S. No.	Descripción de los Bienes
1.	Componentes nano/micro electrónicos como los sistemas microelectromecánicos (MEMS) y los sistemas nanoelectromecánicos (NEMS)
2.	Unidades de montaje, evaluación, marcado y empaquetado (ATMP)

D. Lista de Bienes con un Límite de Umbral de Inversión Mínima de 75 rupias crore

S. No.	Descripción de los Bienes
1.	Partes plásticas y metálicas para aplicaciones electrónicas

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información
(División IPHW)

E. Lista de Bienes con un Límite de Umbral de Inversión Mínima de 250 rupias crore

S. No.	Descripción de los Bienes
1.	Semiconductores de compuestos, tales como GaN, SiC, GaAs, etc., y circuitos integrados/dispositivos de fotónica de silicio, componentes optoelectrónicos

F. Lista de bienes con un Límite de Umbral de Inversión Mínima de 500 rupias crore

S. No.	Descripción de los Bienes
1.	Láminas semiconductoras

G. Lista de Bienes con un Límite de Umbral de Inversión Mínima de 1,000 rupias crore

S. No.	Descripción de los Bienes
1.	Chips integrados semiconductores (IC) incluyendo [microprocesadores, microcontroladores, procesadores de señal digital (DSP), circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), etc.] lógicos; memorias; IC de señal análoga/mixta, etc.
2.	Unidades de fabricación de pantalla incluyendo pantallas de cristal líquido (LCD), diodo emisor de luz (LED), diodo emisor de luz orgánico (OLED), etc., para aplicaciones electrónicas
